

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-064

上海盛剑科技股份有限公司

关于 2025 年度担保额度预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海盛剑半导体科技有限公司
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	15,786.08 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	140,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	83.26
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额即 2025 年度担保预计总额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025 年 8 月 27 日，公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）出具《最高额不可撤销担保书》【121XY250821T000014】（以下简称“本担保书”），自愿为上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）与招商银行上海分行于 2025 年 8 月 27 日签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》【121XY250821T000014】（以下简称“《授信协议》”）项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担连带保证责任，授信期间为 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日。担保的最高本金限额为人民币 3,000.00 万元。盛剑半导体的其他股东方未提供担保。上述担保不存在反担保，本次担保事项已履行相关的审议程序，无需另行审议。

（二）内部决策程序

为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2025 年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）盛剑半导体、合肥盛剑微电子有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限公司、广东盛剑设备有限公司及 SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD. 提供担保额度合计不超过人民币 140,000.00 万元（含等值外币）。其中，对盛剑半导体预计担保额度为不超过人民币 50,000.00 万元。

提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计自股东大会审议通过之日起生效至 2025 年 12 月 31 日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，以及于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日以及 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-098）及《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-003）等相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海盛剑半导体科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有盛剑半导体的股权比例为 85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平台上海勤顺聚芯企业管理合伙企业（有限合伙）、上海勤顺汇芯企业管理合伙企业（有限合伙）控制盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由外部投资者上海榄余坤企业管理中心（有限合伙）持有。
法定代表人	张伟明
统一社会信用代码	91310114MA7EWWBR5P
成立时间	2021 年 12 月 27 日
注册地	上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2450 室
注册资本	11,750 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁，以下限分支机构经营：半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种

	设备制造),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),通用零部件制造,机械零件、零部件加工,环境保护专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日 /2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	56,109.56	59,242.11
	负债总额	35,920.63	43,085.86
	资产净额	20,188.93	16,156.25
	营业收入	6,326.95	15,251.33
	净利润	755.13	2,706.78

三、担保协议的主要内容

1、保证人：上海盛剑科技股份有限公司

2、授信人：招商银行股份有限公司上海分行

3、授信申请人：上海盛剑半导体科技有限公司

4、保证范围：授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 3,000.00 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、保证方式：连带保证责任

6、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7、《授信协议》授信期间：2025 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日

8、本担保书于保证人法定代表人 / 主要负责人或其授权代理人签字 / 盖公章并加盖保证人公章 / 合同专用章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足盛剑半导体业务发展及生产经营的需要，有利于其持

续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。因此，盛剑半导体的其他股东未提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。董事会认为：本次担保额度预计是对公司控股子公司（及其控股子公司）2025 年度可能发生的担保，属于公司控股子公司（及其控股子公司）日常经营和资金使用的合理需要，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过 70%，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额、余额分别为 140,000.00 万元（即 2025 年度担保预计总额）、22,692.45 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 83.26%、13.50%。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日，上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日